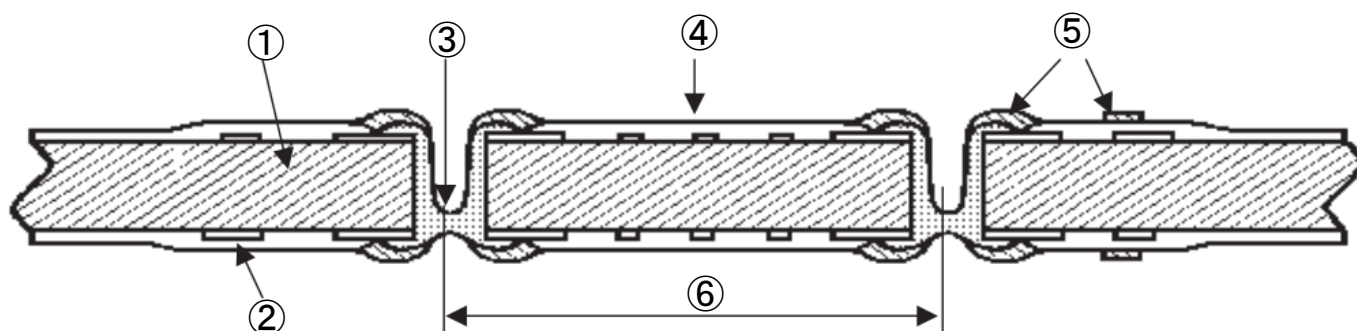


■ 特 徴

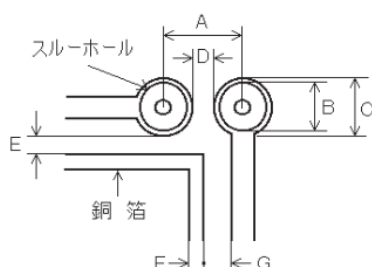
- ・銅メッキスルーホール基板をペーストスルーホール基板に変更することにより、大幅なVA効果が得られます。
- ・高密度回路が容易に製作できます。
- ・両面実装基板が可能です。
- ・ペーストスルーホールを使用しているため、紙フェノール基板が使用でき信頼性があります。

■ 構 造



番号	名 称	番号	名 称
①	基 材	④	ソルダーレジスト
②	銅 箔	⑤	標準兼スルーホールカバーコート
③	スルーホール	⑥	スルーホールピッチ

■ 設計基準



(mm)

スルーホールピッチA	C	D	E	F	G
1.00	0.80	0.20	0.25	0.20	0.20
1.25	1.00	0.25	0.25	0.20	0.20
1.50	1.20	0.30	0.30	0.20	0.20
1.75	1.40	0.35	0.40	0.20	0.20
2.00	1.50	0.50	0.50	0.20	0.20
2.50	2.00	0.50	0.50	0.20	0.20

■ 製品仕様

項 目	仕 様		条 件
	AgTh	CuTh	
基板材質	FR-1,C EM -3		
スルーホール	導電性レジン		銅ペーストスルーホールについては、1.25mmピッチ以上とする。
	銀ペースト	銅ペースト	
使用温度範囲	-30~+100℃		
スルーホール抵抗値	100mΩ/hole	100mΩ/hole	
定格電流	300mA/hole	300mA/hole	1.25mmピッチ以下は250mA/hole
最高使用電圧(異電位間電圧)	50V ※(20V)	100V	※1.25mmピッチ以下に適用
負荷寿命	200mΩ/hole	200mΩ/hole	70℃ 1000Hr
耐湿負荷寿命	200mΩ/hole	200mΩ/hole	40℃ 90~95%RH 1000Hr
高温放置	200mΩ/hole	200mΩ/hole	100℃ 1000Hr
耐湿放置	200mΩ/hole	200mΩ/hole	40℃ 90~95%RH 1000Hr
はんだ耐熱	200mΩ/hole	200mΩ/hole	260℃ 5 sec
リフロー耐熱	200mΩ/hole	200mΩ/hole	240℃ 3 sec
銀移行	200mΩ/hole	200mΩ/hole	40℃ 90~95%RH 1000Hr
ホットオイル	200mΩ/hole	200mΩ/hole	260℃ 10sec 100 Cycle
ヒートサイクル	200mΩ/hole	200mΩ/hole	-40℃ ⇄ 100 30min 100 Cycle

■特 性 値(参考値)

- ・ Ag Th : 銀ペースト(1.5mm ピッチ FR-1 t=1.6mm)
- ・ Cu Th : 銅ペースト(1.5mm ピッチ FR-1 t=1.6mm)

